

# 台灣人居環境全生命週期管理學會

## 2023 秋季論壇－降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰

### 邀請函

敬愛的會員先進、營建業夥伴：

聯合國 IEA 報告指出全球溫室氣體排放占比 38%的建築營建部門中，有 28%是建築能源使用部分的溫室氣體排放，稱為營運碳排(OC, Operational Carbon)；另外 10%是鋼筋、水泥、玻璃等建材的製造運輸與施工的溫室氣體排放，稱為蘊含碳排(EC, Embodied Carbon)。淨零建築的減碳策略應兩者兼顧。

為了達到淨零建築，世界各國著手制定能源轉型和減碳政策，淨零排放成為國際推動趨勢，我國更於 2022 年公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，並於 2023 年通過《氣候變遷因應法》，全力朝減碳轉型路徑發展。

本學會就 ESG 浪潮下的機電設計及設施管理之議題，將於 2023 年 9 月 15 日下午在台北矽谷國際會議中心 2B 國際會議廳辦理「秋季論壇：降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰」，並邀請四位專家學者蒞臨分享國內外相關經驗，協助 BLM 學會會員及營建業夥伴穩健面對 ESG 新浪潮。

本次論壇的講者分別來自三大外商顧問公司 WSP、AECOM、ARUP 及工一科技。面對國際淨零碳排趨勢，四位專家學者將透過本次論壇，分享營建產業在 ESG 浪潮下該如何改善機電設施以達節約能源之目的，實踐 ESG，共同邁向淨零永續。

謹竭誠邀請您撥冗參與台灣人居環境全生命週期管理學會(BLM 學會) 2023 秋季論壇：降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰！

台灣人居環境全生命週期管理學會 王明德理事長 敬邀

2023/7/18

# 台灣人居環境全生命週期管理學會

## 2023 秋季論壇：降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰

- **時間**：112 年 9 月 15 日 (星期五) 13:00 - 17:00
- **地點**：台北矽谷國際會議中心 2B 國際會議廳 (新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓)
- **主辦單位**：台灣人居環境全生命週期管理學會
- **參加對象**：學會會員及受邀人員

### 議程

|    | 起訖時段        | 專題 / 項目  |
|----|-------------|--|
| 30 | 13:00-13:30 | 報 到  |
|    | 主持人         | 林恭平 國際及兩岸交流委員會主委 / 台灣人居環境全生命週期管理學會<br>總經理 / WSP 美商科進栢誠工程顧問有限公司台灣分公司  |
| 10 | 13:30-13:40 | 開幕致詞<br>王明德 理事長 / 台灣人居環境全生命週期管理學會  |
| 40 | 13:40-14:20 | ESG Airport - WSP International Experience<br>Aldeburgh, Tim / Technical Director, Project Management & Advisory<br>WSP 美商科進栢誠工程顧問有限公司 |
| 40 | 14:20-15:00 | 永續設計對企業 ESG 績效指標的影響<br>鄭長芳 永續資深顧問 / ARUP 奧雅納工程顧問有限公司   |
| 20 | 15:00-15:20 | 中場休息與交流  |
|    | 主持人         | 戴期甦 國際及兩岸交流委員會副主委 / 台灣人居環境全生命週期管理學會<br>副總裁 / AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司   |
| 40 | 15:20-16:00 | 整合式設計 IDP 助力建築全生命週期碳減排<br>劉洋 永續服務副總監 / AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司   |
| 40 | 16:00-16:40 | 能源管理與碳排的整合應用系統<br>潘少偉 執行長 / Onework 工一科技有限公司   |
| 20 | 16:40-17:00 | 綜合討論   |
|    | 17:00       | 散 會  |

台灣人居環境全生命週期管理學會  
2023 秋季論壇：降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰

報名方式

- 活動日期：112 年 9 月 15 日 (星期五) 13:00 - 17:00
- 主辦單位：台灣人居環境全生命週期管理學會
- 參加對象：學會會員及受邀人員
- 聯絡窗口：BLM 學會秘書處 林念穎
- 聯絡電話：02-2918-8798 #381
- E-mail：tw.belm@outlook.com
- 報名網址：<https://forms.office.com/r/KqpuR01C7J>

(點選上方網址或掃描右方 QRcode 報名)



- 會場資訊：台北矽谷國際會議中心 2B 國際會議廳
  1. 電話：02-8911-2668
  2. 地址：231 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(與彭園同一棟)
  3. 交通方式：
    - 搭乘公車：642、643、644、648、650、綠 10、綠 13
    - 搭乘捷運：搭捷運至大坪林站，1 號出口，過馬路後經由 42 巷進入，或 4 號出口，順過馬路沿民權路或北新路往景美橋方向直行至台北矽谷大樓
    - 自行駕車：矽谷II大樓正門口轉彎處(全家便利商店旁地下停車場)



【主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利】